

エンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」に  
POWER5+プロセッサを搭載したハイエンドモデルを追加  
同時にエントリーモデルの処理性能も強化



EP8000 595  
POWER5+搭載モデル

日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:篠本 学、以下 日立)は、このたび、高性能・高信頼のミッションクリティカルなエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、最新プロセッサ POWER5+を搭載し、処理性能を大幅に強化したハイエンドモデルの「EP8000 595」POWER5+搭載モデル、「EP8000 590」POWER5+搭載モデルをラインアップに追加し、8月24日から販売を開始します。

「EP8000 シリーズ」は、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を搭載した UNIX サーバです。「EP8000 595」はプロセッサを SMP 構成で最大 64way まで、「EP8000 590」は最大 32way まで搭載可能なハイエンドモデルで、高い処理性能に加え仮想化機能を備えることにより、システムリソースの有効活用を可能とし、TCO の削減とビジネス規模の変化への迅速な対応を実現します。

この「EP8000 595」「EP8000 590」に POWER5+を採用したモデルを、今回ラインアップに追加しました。最新プロセッサの搭載により、「EP8000 595」POWER5+搭載モデルでは、現行の POWER5 搭載モデルに比べトランザクション処理で最大約 25%性能を向上し、業界最高水準の性能を実現しました。また「EP8000 590」POWER5+搭載モデルでは POWER5 搭載モデルに比べトランザクション処理で最大約 30%の性能向上を実現しています。

同時に、1U サイズのエントリーモデル「EP8000 505」において、新たに POWER5+搭載モデルを追加したほか、エントリーモデル「EP8000 550Q」「EP8000 550」「EP8000 520Q」「EP8000 520」にプロセッサ動作周波数を向上したエンハンスモデルを追加しました。

今回のラインアップ追加により、ハイエンドからエントリーまで全てのモデルで POWER5+の搭載を実現しました。「EP8000 シリーズ」は、ワークグループサーバなどの小規模システムから全社レベルの大規模基幹システムまで、様々なユーザーニーズに、より幅広く対応し、これからの情報化社会の基盤を支えるプラットフォームとして利用できます。

## ■新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ (周波数)	最大プロセッサ数 (way)	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 595	専用ラックマウント	POWER5+(2.1/2.3GHz)	64	8GB～2TB	最大 240
EP8000 590		POWER5+(2.1GHz)	32	8GB～1TB	最大 160
EP8000 550Q	ラックマウント/タワー	POWER5+(1.65GHz)	8	8GB～64GB	最大 61
EP8000 550		POWER5+(2.1GHz)	4	4GB～64GB	
EP8000 520Q		POWER5+(1.65GHz)	4	4GB～32GB	最大 34
EP8000 520		POWER5+(2.1GHz)	2	2GB～32GB	
EP8000 505	ラックマウント	POWER5+(1.9GHz)	2	2GB～26GB	2

## ■新製品の価格と出荷時期

モデル	形状	価格	出荷時期
EP8000 595	専用ラックマウント	1 億 5,962 万円 ～ (税抜 1 億 5,202 万円～)	2006 年 11 月 20 日
EP8000 590		9,034 万円 ～ (税抜 8,604 万円～)	
EP8000 550Q	ラックマウント/タワー	518 万円 ～ (税抜 494 万円～)	2006 年 10 月 13 日
EP8000 550		444 万円 ～ (税抜 423 万円～)	
EP8000 520Q		351 万円 ～ (税抜 334 万円～)	2006 年 11 月 20 日
EP8000 520		296 万円 ～ (税抜 282 万円～)	2006 年 10 月 13 日
EP8000 505	ラックマウント	146 万円 ～ (税抜 139 万円～)	

## ■他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5、POWER5+は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## ■製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/EP8000/>

## ■取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部 企画部 【担当:喜多村】  
〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地  
電話:0463-87-6786(ダイヤルイン)

以上

## ■新製品の特徴

## 1. 各モデルの特徴

## (1)「EP8000 595」「EP8000 590」POWER5+搭載モデル

「EP8000 595」POWER5+搭載モデルは、最新プロセッサ POWER5+(2.1/2.3GHz)を最大 64way まで搭載可能なハイエンドモデルです。POWER5 を搭載した現行の「EP8000 595」に比ベトランザクション処理性能を最大約 25%向上し、業界最高水準の非常に優れた処理性能を発揮します。

「EP8000 590」POWER5+搭載モデルは、POWER5+(2.1GHz)を最大 32way まで搭載可能なハイエンドモデルです。POWER5 を搭載した現行の「EP8000 590」に比ベトランザクション処理性能を最大約 30%向上し、他社ハイエンドモデルを上回る高い性能をミッドレンジモデルの価格帯で実現しています。

また、「EP8000 595」では、メモリは最大 2TB、PCI-X スロットは最大 240 スロットまで拡張可能で、「EP8000 590」では、メモリは最大 1TB、PCI-X スロットは最大 160 スロットまで拡張可能です。

非常に優れた処理性能とシステム拡張性を兼ね備えることにより、大規模業務システムから大規模データベース、OLTP、データウェアハウス、さらには多数のサーバを統合する大規模なサーバコンソリデーションなどに最適なモデルです。

## (2)「EP8000 505」POWER5+搭載モデル

「EP8000 505」は筐体のサイズが 1U(高さ約 44.5mm)と非常に薄型の高密度・省スペースなエントリーサーバです。現行の POWER5 搭載モデルに比べ、POWER5+(1.9GHz)を搭載したモデルはトランザクション処理で約 26%の性能向上を図り、2way 構成のエントリーサーバで 4U サイズの「EP8000 520」POWER5+搭載モデルと同等の処理性能を発揮します。最大 26GB までメモリ増設ができ、PCI-X スロットを 2 スロット備えるなど十分な拡張性を備えています。

Web サーバなどのフロントエンドサーバを含めて高信頼なシステムを構築したい場合や、インターネットデータセンタや高性能クラスタシステムのノードなどスケールアウト型のシステムに非常に適しています。

## (3)「EP8000 550Q」「EP8000 520Q」POWER5+(1.65GHz)搭載モデル

「EP8000 550Q」「EP8000 520Q」は 2way 構成の POWER5+を 2 個搭載したプロセッサモジュールを採用したエントリーモデルで、「EP8000 550Q」は「EP8000 550」に比べ同じ 4U の筐体サイズで 2 倍のプロセッサ数の 8way 構成を実現したモデル、同様に「EP8000 520Q」は「EP8000 520」に比べ 2 倍のプロセッサ数の 4way 構成を実現したモデルです。

現行の POWER5+(1.5GHz)搭載モデルに比べ、1.65GHz の POWER5+を搭載したモデルは、トランザクション処理性能で約 10%の性能向上を実現しています。

## (4)「EP8000 550」「EP8000 520」POWER5+(2.1GHz)搭載モデル

「EP8000 550」はプロセッサを SMP 構成で最大 4way まで、「EP8000 520」は最大 2way まで搭載可能なエントリーモデルです。現行の POWER5+(1.9GHz)搭載モデルに比べ、2.1GHz の POWER5+を搭載したモデルは、トランザクション処理性能で約 10%の向上を実現しています。

## 2. 仮想化機能をサポート

新モデルは、現行モデル同様、マイクロパーティショニング機能に対応した動的論理分割(Dynamic LPAR (\*1))をサポートしています。マイクロパーティショニング機能により、1 つのプロセッサを論理的に分割し最大 10 パーティションで共有することが可能です。1 システムあたり「EP8000 595」「EP8000 590」では

最大 254 パーティション、「EP8000 550Q」では最大 80 パーティション、「EP8000 550」「EP8000 520Q」では最大 40 パーティション、「EP8000 520」「EP8000 505」では最大 20 パーティションに分割できます。物理的なプロセッサ数にとらわれることなく各パーティションにプロセッサ能力を割り当てられるため、システムの使用効率高めることが可能です。このほか、LAN およびストレージの仮想化機能もサポートしています。

このような仮想化機能により、ハードウェアリソースをより有効に活用することを可能とし、TCO の削減とビジネス規模の変化に合わせた迅速かつ柔軟なシステム構成の変更・増強を実現することができます。

(\*1) LPAR:Logical PARTitioning

### 3. メインフレームクラスの信頼性と可用性

今回の新モデルも従来の「EP8000 シリーズ」と同様、動的プロセッサ切り離し機能、PCI バス障害回復機能、動的 PCI アダプタ切り離し機能など、様々な高信頼化機能をサポートしています。これにより、システム停止につながる障害発生を大幅に低減します。

また、高可用性ソフトウェア「HA モニタ」とスケラブルデータベース「HiRDB」によるクラスタ構成において、現用系システムの OS 障害発生と同期した待機系システムへの即時切替え通知や、現用系システムから待機系システムへの共有ディスクの高速切替えを実現するソフトウェア「HA Booster Pack for AIX」を用いることにより、これまで数分程度の時間を必要とした障害時のシステム系切替えを十数秒という極めて短い時間に実行することができるなど、ハードウェアとしてだけでなく、システム運用面での高い信頼性・可用性も備えています。

### 4. 最新のソフトウェア環境を提供

オペレーティングシステム(OS)は、POWER5+搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す米国 IBM 社の最新版 UNIX OS「AIX 5L V5.3」に対応しています。

「AIX 5L V5.3」は、優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能も提供します。ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェア製品に加え、DBMS(\*2)製品 Oracle<sup>®</sup>や SAP<sup>®</sup> R/3<sup>®</sup>を含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com<sup>®</sup>など豊富な ISV(\*3)製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステムを構築することが可能です。

(\*2) DBMS:DataBase Management System

(\*3) ISV:Independent Software Vendor

#### ■他社所有商標に関する表示

- AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- Oracle は、米国 Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の登録商標です。
- POWER5+、POWER5 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- SAP<sup>®</sup>、R/3<sup>®</sup>、mySAP.com<sup>®</sup>は、SAP AG のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
- UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■ 新製品の仕様

モデル		EP8000 590	EP8000 595
形状		専用ラック筐体	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	POWER5+
	クロック・レート(GHz)	2.1	2.1/2.3
	プロセッサ数(way)	8~32	16~64
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	1.9 (2wayあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	36 (2wayあたり)
メモリ容量	最小~最大(GB *1)	8~1,024 *3	8~2,048 *4
ディスク容量	最小~最大(GB *2)	72.8~9,395.2 *5	72.8~14,092.8 *6
拡張PCI-Xスロット本数		20 (I/Oドローアあたり)	
I/Oドローア数		1~8	1~12
外形寸法 (W×D×H:mm)	搭載筐体	専用ラック筐体 785×1,681×2,025 (1ラック構成) 1,575×1,681×2,025 (2ラック構成)	
	電源電圧(V)	200~240 (三相)	
省エネ法に 基づく表示	区分	C	C
	エネルギー消費効率	0.1888	0.0977
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

モデル		EP8000 550Q POWER5+(1.65GHz)搭載モデル	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	1.65	
	プロセッサ数(way)	4	4/8
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小~最大(GB *1)	8~32	8~64
ディスク容量	最小~最大(GB *2)	146.8~2,400	146.8~16,492.8 *7
拡張PCI-Xスロット本数		5	5~61 *7
I/Oドローア数		—	0~8
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドローア	—	437×686×178 (4U *8)
	I/Oドローア	—	482×610×178 (4U *8)
	搭載筐体	201×779×533	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *9
電源電圧(V)		100~127 (単相)	100~127 *10 /200~240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.0331	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

モデル		EP8000 550 POWER5+(2.1GHz)搭載モデル	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	2.1	
	プロセッサ数(way)	2	2/4
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	4～32	4～64
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400	146.8～16,492.8 *7
拡張PCI-Xスロット本数		5	5～61 *7
I/Oドロー数		—	0～8
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	—	437×686×178 (4U *8)
	I/Oドロー	—	482×610×178 (4U *8)
	搭載筐体	201×779×533	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *9
電源電圧(V)		100～127 (単相)	100～127 *11 /200～240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.0331	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

モデル		EP8000 520Q POWER5+(1.65GHz)搭載モデル	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	1.65	
	プロセッサ数(way)	4	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	4～32	
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400	146.8～9,446.4 *12
拡張PCI-Xスロット本数		6	6～34 *12
I/Oドロー数		—	0～4
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	—	442×573×172 (4U *8)
	I/Oドロー	—	482×610×178 (4U *8)
	搭載筐体	190×590×535	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *9
電源電圧(V)		100～127 (単相)	100～127/200～240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.048	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

モデル		EP8000 520 POWER5+(2.1GHz)搭載モデル	
形状		タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	2.1	
	プロセッサ数(way)	2	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	2～32	
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8～2,400	146.8～9,446.4 *12
拡張PCI-Xスロット本数		6	6～34 *12
I/Oドローワー数		—	0～4
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドローワー	—	442×573×172 (4U *8)
	I/Oドローワー	—	482×610×178 (4U *8)
	搭載筐体	190×590×535	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *9
電源電圧(V)		100～127 (単相)	100～127/200～240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	区分	F	
	エネルギー消費効率	0.048	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

モデル		EP8000 505 POWER5+搭載モデル	
形状		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5+	
	クロック・レート(GHz)	1.9	
	プロセッサ数(way)	2	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2wayあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2wayあたり)	
メモリ容量	最小～最大(GB *1)	2～26	
ディスク容量	最小～最大(GB *2)	146.8	
拡張PCI-Xスロット本数		2	
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドローワー	440×710×43 (1U *8)	
	搭載筐体	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *9	
電源仕様	電圧(V)	100～127/200～240 (単相)	
	周波数(Hz)	50または60	
省エネ法に 基づく表示	区分	I	
	エネルギー消費効率	0.0425	
搭載OS		AIX 5L V5.3 または AIX 5L V5.2	

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

(\*1) 1MB(メガバイト)=1,024<sup>2</sup>バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024<sup>3</sup>バイトです。

(\*2) 1GB(ギガバイト)=1,000<sup>3</sup>バイトです。

(\*3) 2007年3月末までにサポート予定。それまでは最大512GBとなります。

(\*4) 2007年3月末までにサポート予定。それまでは最大1,024GBとなります。

(\*5) I/Oドローワー 8台接続時

(\*6) I/Oドローワー 12台接続時

(\*7) I/Oドローワー(ディスクベイ有) 8台接続時。

(\*8) ラック搭載時の占有サイズ(1U:高さ約44.5mm)。

(\*9) ラック筐体は、下記のうちから選択できます。(11Uラック筐体は EP8000 505 のみ選択可能)

11Uラック筐体(格納サイズ 11U) 外形寸法 520×874×612 (W×D×H:mm)

23Uラック筐体(格納サイズ 23U) 外形寸法 647×1,104×1,193 (W×D×H:mm)

36Uラック筐体(格納サイズ 36U) 外形寸法 647×1,104×1,798 (W×D×H:mm)

42Uラック筐体(格納サイズ 42U) 外形寸法 647×1,104×2,015 (W×D×H:mm)

(\*10) 4way時のみ。

(\*11) 2way時のみ。

(\*12) I/Oドローワー(ディスクベイ有) 4台接続時。

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---